

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

苏州昀冢电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>电话会议</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div>
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的全体投资者
会议时间	2024 年 11 月 11 日 15:00-16:00
会议地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：王宾 董事会秘书、财务总监：陈艳 独立董事：董炳和
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：目前公司 MLCC 投资项目进展如何？预计能带来怎样的效益？</p> <p>答：MLCC 业务为公司中长期策略发展领域，现阶段已建立完善的工艺流程、全面的品质管理体系，公司将持续加速 MLCC 高容量、小尺寸等重点产品的研发和市场布局。此外，为助力公司 MLCC 项目进一步发展，以技术专家、管理层、骨干员工等为合伙人设立的投资方近期将对 MLCC 项目实施主体池州昀冢电子科技有限公司增资（具体内容详见公司已披露的相关公告），此次增资扩股事项将在优化股东结构、推动后续战略投资者引进及市场化运作的同时，有效提升公司经营管理团队的积极性和凝聚力。</p> <p>问题 2：公司与华为手机制造产线是否有业务</p>

联系？公司是否在智能手机领域持续突破？

答：公司直接客户主要为各大 **VCM** 马达厂商和 **CCM** 模组厂商，非直接向终端品牌客户供货。公司与业内领先的摄像头模组以及马达企业合作，终端应用于华为、小米、**OPPO**、**VIVO**、荣耀、传音等主流品牌智能手机中。公司秉承以技术创新驱动企业发展的理念，在挖掘 **CMI** 产品价值空间的基础上，不断开发具有差异化及市场竞争力的产品，未来将持续拓展智能手机领域的市场份额。

问题 3：公司汽车电子和 CMI 组件进展如何，汽车零件有没有大规模量产？

答：在汽车电子方面，公司主要涉及底盘线控制动系统，转向系统以及电子门窗系统，其中，重点布局的线控底盘制动系统领域主要包括 **ABS**、**ESC**、**ONE BOX** 等产品。目前公司汽车电子类产品已通过京西重工、万向精工、三井金属、拿森汽车等汽车系统一级供应商的认证。在 **CMI** 方面，公司通过将 **CMI** 产品下沉到单机价格千元左右的手机终端应用，持续带动一二代 **CMI** 产品的出货量。同时，在高端机型和旗舰机领域，公司重点推进 **CMI** 三代及四代产品在高端旗舰机的使用量，特别是潜望式及可变式光圈的市场应用，以进一步提高公司盈利能力和市场竞争力。

问题 4：公司在过去几年持续出现亏损，今年已经进入第四季度，三季度仍然出现较大幅度的亏损，管理层有何举措改善此状况以实现扭亏？

答：公司三季度亏损主要原因系池州昀冢电子科技有限公司的 **MLCC** 投资项目进入小批量量产阶段，营业收入较小，前三季度在建工程转固导致折旧等相关费用大幅增加，以及人工、材料等运营成本增加，导致同比亏损扩大。后续伴随着 **MLCC** 产品的材料成本及工艺优化、产能提升，**MLCC** 产品进入爬坡期后，公司净利润指标有望改善。

问题 5：能否详细说明一下公司 MLCC 生产最新状态，产能饱和度已到什么程度？公司产品投放

市场后，客户反馈怎么样？特别是华为、小米、VIVO 等手机大厂，是否已渗透贵公司的 MLCC 新产品？

答：2024 年为公司 MLCC 产品销售元年，产品包括 0201、0402 等尺寸的系列产品，覆盖消费电子、汽车电子、通信及其他工业等多领域市场应用。目前公司 MLCC 产品通过经销商代理模式进行销售。公司持续加速 MLCC 高容量、小尺寸等重点产品的研发和市场布局。

问题 6：公司三季度营收有较大下滑，请问是什么原因导致的？

答：受新机发布节奏等影响，公司 2024 年第三季度营收有所下滑，后续伴随四季度国内主流智能手机新机型的陆续发布，有望带动公司 CMI 产品出货量。此外，由于池州昀钎半导体材料有限公司增资完成后已不再纳入公司合并报表范围，出表事项对公司营收有所影响。

问题 7：公司前三季度研发费用有所增加，主要用于哪些领域？公司未来研发创新规划如何？

答：公司前三季度研发费用主要用于电子陶瓷及消费电子等领域。未来公司将持续创新，开发具有差异化及市场竞争力的产品，为公司创造盈利增长点。

问题 8：公司在三费方面有哪些控制措施？

答：公司通过完善薪酬体系、提升治理水平、加强资金及应收账款管理、采取多元化融资等手段管控相关费用。

问题 9：报告期内公司经营性现金流情况如何？其他关键财务指标是否有所改善？

答：年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,757.18 万元。公司将持续聚焦主业，强化研发能力，重点推进主要产品在手机光学领域的市场应用；同时加速电子陶瓷领域的研发和市场拓展，持续提升 MLCC 和 DPC 产品的工艺及技术水平，为公司创造新的营收增长点；此外，公

	<p>司将采取多元的融资手段，有效改善资本结构及现金流。公司致力于通过多方面举措提升各项财务指标健康度，推动公司稳健发展。</p> <p>问题 10：公司作为一家被美国纳入制裁名单的高科技公司。请问被制裁以后，对公司的业务拓展特别是海外市场的拓展会带来哪些不利影响？公司管理团队，又如何应对这种制裁局面，如何突围成功？</p> <p>答：公司已于 2022 年 10 月从“未经核实清单”（Unverified List）中移除，相关事件不会对公司业务产生不利影响。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单	无
日期	2024 年 11 月 12 日